

上海骄成超声波技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-015

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div><div><input type="checkbox"/>分析师会议</div><div><input type="checkbox"/>媒体采访</div><div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div><div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div><div><input type="checkbox"/>路演活动</div><div><input type="checkbox"/>现场参观</div><div><input type="checkbox"/>电话会议</div><div><input type="checkbox"/>其他</div></div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | 财通证券、冲积资产、青骊投资、浙商资管、真科基金、汇升投资、国海证券、东财基金、华创证券                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 会议时间          | 2025 年 10 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 会议地点          | 公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书、财务总监：孙凯<br>副总经理：石新华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>Q1、在半导体先进封装领域超声波检测的原理以及与 X 光检测等方式的区别？</div> <div>A1、在半导体先进封装领域，超声波检测与 X 射线均能够检测工件内部缺陷，X 射线检测的优势在于检测存在密度差异的缺陷，超声波检测则对声阻抗差异敏感，对于内部的平面型缺陷或界面缺陷，如裂纹、未熔合、界面分层等情况，超声波的反射特性优势明显，超声波在界面会大量反射，产生极其强烈的回波信号，利用界面声阻抗差异，超声波检测技术可精准、无损伤地探测出半导体晶圆、2.5D/3D 封装、芯片贴装等内部缺陷。</div> <div>Q2、公司先进超声波检测设备能够快速、顺利推出的原因？</div> <div>A2、经过多年的研发和技术积累，公司已形成了以超声波技术为核心的超声波技术平台并组建了在超声波行业经验丰富</div>              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>的技术开发、设计和管理团队，可以为客户提供从超声波电源设计与开发、压电换能器仿真设计与开发、声学工具设计等超声波应用整体解决方案。公司在声学、软件、算法等方面有着深刻理解和坚实基础，在运动控制、精密机械等方面持续提升，通过及时了解客户需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，配合客户的工艺改进，快速响应市场需求。</p> <p>Q3、公司超声波检测设备在半导体传统封装领域是否有应用？</p> <p>A3、公司超声波扫描显微镜可广泛应用于新能源电池、IGBT功率模块、电子元器件、液冷板、金刚石复合片、陶瓷基板、半导体芯片、晶圆等工件内部缺陷检测。在功率半导体领域，公司有超声波端子焊接机、超声波 PIN 针焊接机、超声波键合机、超声波扫描显微镜等全工序超声波解决方案，并均已实现批量出货。在该领域，公司与上汽英飞凌、中车时代、振华科技、宏微科技、士兰微、芯联集成等知名企业保持良好合作。</p> <p>Q4、公司半导体设备主要竞争对手是哪些？</p> <p>A4、在半导体封测环节，核心超声波设备国产化率较低，进口设备如 K&amp;S、ASM、德国 PVA、美国 Sonoscan 在超声波键合机、超声波扫描显微镜等领域占有较高市场份额。公司凭借自身在超声波行业多年的技术积累，紧跟国内半导体产业升级发展需求和技术发展趋势，逐渐打破行业内外资竞争对手的垄断局面，市场份额呈逐渐上升的趋势。</p> <p>Q5、固态电池领域是否有超声波技术应用？</p> <p>A5、公司密切关注新能源领域前沿技术发展趋势，在固态电池领域推出了超声波极耳焊接、超声波检测等多款设备，积极延伸超声技术应用场景，打开更广阔的市场空间。</p> |
| 附件清单(如有) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 日期       | 2025 年 10 月 16 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |